

ELMOS Semiconductor AG
Dortmund

Jahresabschluss und Lagebericht
31. Dezember 2007

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dortmund, 3. März 2008

Ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Muzzu	Krebs
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

ELMOS Semiconductor AG, Dortmund
Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2006 TEUR	PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2006 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	19.414.205,00		19.414
1. Software und Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	11.733.221,63		11.948	II. Kapitalrücklage	84.784.588,35		84.782
2. Geleistete Anzahlungen	<u>2.025.342,81</u>		997	III. Gewinnrücklagen			
		13.758.564,44	<u>12.945</u>	Andere Gewinnrücklagen	102.223,64		102
II. Sachanlagen				IV. Bilanzgewinn	<u>39.621.311,85</u>		44.938
1. Grundstücke und Bauten	10.846.122,00		9.828		143.922.328,84		<u>149.236</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	33.014.796,75		31.365				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.854.388,98		3.150				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>8.508.444,32</u>		4.237				
		55.223.752,05	<u>48.580</u>	B. RÜCKSTELLUNGEN			
III. Finanzanlagen				1. Rückstellungen für Pensionen	1.838.444,56		1.790
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	63.349.420,79		63.349	2. Steuerrückstellungen	57.943,00		251
2. Beteiligungen	54.825,41		81	3. Sonstige Rückstellungen	<u>7.536.761,91</u>		6.181
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	304.140,84		1.601		9.433.149,47		<u>8.222</u>
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		1.652	C. VERBINDLICHKEITEN			
5. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen	<u>1.627.138,00</u>		1.420	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.114.833,57		31.603
		65.335.525,04	<u>68.103</u>	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		69
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.819.408,16		7.632
		<u>134.317.841,53</u>	<u>129.628</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.314.469,16		23.342
B. UMLAUFVERMÖGEN				5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.786.346,29		15
I. Vorräte				6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>938.810,46</u>		1.331
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.626.807,78		6.773		85.973.867,64		<u>63.992</u>
2. Unfertige Erzeugnisse	17.119.461,02		15.773	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		650.347,11	8
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>5.920.559,50</u>		2.871				
		29.666.828,30	<u>25.417</u>				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.552.779,53		23.240				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.253.002,54		5.246				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	122.088,43		44				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.455.252,83</u>		19.120				
		32.383.123,33	<u>47.650</u>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
		38.220.306,92	<u>12.870</u>				
		<u>100.270.258,55</u>	<u>85.937</u>				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
		5.391.592,98	5.893				
		<u>239.979.693,06</u>	<u>221.458</u>				
					<u>239.979.693,06</u>		<u>221.458</u>

ELMOS Semiconductor AG, Dortmund
Gewinn- und Verlustrechnung für 2007

	EUR	EUR	2006 TEUR
1. Umsatzerlöse	158,351,606.78		143,136
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4,396,050.14		1,626
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	197,371.83		386
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3,897,498.95</u>		<u>3,722</u>
		166,842,527.70	<u>148,870</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	-21,212,045.77		-18,828
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-46,786,184.71		-39,821
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-31,416,260.44		-28,442
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 127.499,20 (Vj. TEUR 155)	-5,626,756.24		-5,198
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13,008,622.57		-11,009
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-53,047,366.98</u>		<u>-43,245</u>
		-171,097,236.71	<u>-146,543</u>
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.928.057,73 (Vj. TEUR 2.697)	1,928,057.73		2,697
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 37.961,07 (Vj. TEUR 100)	769,072.68		406
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0.00		-176
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 1.362.039,02 (Vj. TEUR 783)	-3,479,872.48		-1,993
		<u>-782,742.07</u>	<u>934</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-5,037,451.08	<u>3,261</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-23,539.29		-446
15. Sonstige Steuern	<u>-255,448.84</u>		<u>-410</u>
		<u>-278,988.13</u>	<u>-856</u>
16. Jahresfehlbetrag (-)/überschuss (+)		-5,316,439.21	+2,405
17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		<u>44,937,751.06</u>	<u>42,533</u>
18. Bilanzgewinn		<u>39,621,311.85</u>	<u>44,938</u>

ELMOS Semiconductor AG, Dortmund

Anhang für 2007

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (3 - 8 Jahre, lineare Methode) vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbsterstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten einbezogen. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze abgeschrieben. Soweit steuerlich zulässig, wird für bewegliche Anlagegüter die degressive Abschreibungsmethode angewandt. Der Übergang zur linearen Methode erfolgt in dem Jahr, für welches die lineare Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Bei den **Finanzanlagen** werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Ansprüche aus Rückdeckungsversicherung werden zum Aktivwert angesetzt.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.

Die **unfertigen und fertigen Erzeugnisse** sind auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen entsprechend dem steuerrechtlichen Mindestumfang berücksichtigt werden. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Verkaufspreisen Abschläge für noch anfallende Kosten vorgenommen.

Alle erkennbaren Risiken im **Vorratsvermögen**, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die **Rückstellungen für Pensionen und Vorruhestandsverpflichtungen** werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt. Die Teilwerte gemäß § 6a EStG wurden unter Verwendung der „Heubeck-Richttafeln 2005 G“ aufgrund einer Änderung der biometrischen Grundlagen erstmalig in 2005 neu berechnet. Es liegt ein Rechnungszinsfuß von 6 % zugrunde.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zuschüsse auf Entwicklungsleistungen werden als Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Fremdwährungen wurden zu Umrechnungskursen am Tage ihrer Entstehung oder zu niedrigeren bzw. höheren Stichtagskursen bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im nachfolgenden Anlagenspiegel dargestellt.

Entwicklung des Anlagevermögens 2007

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				31/12/2007 EUR	Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte		
	1/1/2007	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge		1/1/2007	Zugänge	Abgänge	31/12/2007	31/12/2007	31.12.2006
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
1. Software und Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	24,961,498.42	792,108.25	1,795,826.15	0.00	27,549,432.82	13,013,910.14	2,802,301.05	0.00	15,816,211.19	11,733,221.63	11,948
2. Geleistete Anzahlungen	997,316.56	1,144,455.27	-116,429.02	0.00	2,025,342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,342.81	997
	25,958,814.98	1,936,563.52	1,679,397.13	0.00	29,574,775.63	13,013,910.14	2,802,301.05	0.00	15,816,211.19	13,758,564.44	12,945
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und Bauten	13,389,144.69	1,793,208.61	1,503,188.32	337,344.90	16,348,196.72	3,561,667.19	1,940,407.53	0.00	5,502,074.72	10,846,122.00	9,828
2. Technische Anlagen und Maschinen	102,646,179.47	2,619,112.50	6,112,621.93	2,222,390.71	109,155,523.19	71,281,357.75	7,015,162.18	2,155,793.49	76,140,726.44	33,014,796.75	31,365
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,343,053.40	688,723.58	306,016.86	456,068.80 ¹	9,881,725.04	6,193,261.64	1,250,751.81	416,677.39 ¹	7,027,336.06	2,854,388.98	3,150
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4,237,395.66	12,234,495.63	-7,949,035.55	14,411.42	8,508,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508,444.32	4,237
	129,615,773.22	17,335,540.32	-27,208.44	3,030,215.83	143,893,889.27	81,036,286.58	10,206,321.52	2,572,470.88	88,670,137.22	55,223,752.05	48,580
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	63,349,420.79	0.00	0.00	0.00	63,349,420.79	0.00	0.00	0.00	0.00	63,349,420.79	63,349
2. Beteiligungen	567,751.77	0.00	0.00	26,433.79	541,317.98	486,492.57	0.00	0.00	486,492.57	54,825.41	81
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1,600,892.81	128,177.16	0.00	1,424,929.13	304,140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	304,140.84	1,601
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1,652,188.69	0.00	-1,652,188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652
5. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen	1,419,646.00	207,492.00	0.00	0.00	1,627,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,138.00	1,420
	68,589,900.06	335,669.16	-1,652,188.69	1,451,362.92	65,822,017.61	486,492.57	0.00	0.00	486,492.57	65,335,525.04	68,103
	224,164,488.26	19,607,773.00	0.00	4,481,578.75	239,290,682.51	94,536,689.29	13,008,622.57	2,572,470.88	104,972,840.98	134,317,841.53	129,628

¹ Davon fiktiver Abgang geringwertiger Wirtschaftsgüter in Höhe von EUR 162.907,32.

Angaben zum Anteilsbesitz

	Währung	Beteiligungen %	Eigenkapital in TEUR/LW	Ergebnis in Tausend
Inland				
Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt	EUR	33,33	271	184 ¹
attoSENSOR GmbH, Penzberg	EUR	45,00	60	7
ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG, Dortmund	EUR	100,00	173	168 ²
ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG, Dortmund	EUR	100,00	92	338 ²
ELMOS Semiconductor Süd GmbH, Unterschleißheim	EUR	100,00	175	-2 ²
Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	EUR	100,00	30	6 ¹
GED Gärtner Electronic Design GmbH, Frankfurt/Oder	EUR	73,90	1.000	282
Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH, Dortmund	EUR	100,00	--	-- ³
IndustrieAlpine Bauträger GmbH, München	EUR	51,00	-865	-114
Mechaless Systems GmbH, Karlsruhe	EUR	51,00	741	8
ELMOS Industries GmbH, Hanau	EUR	49,00	-755	-693
Dresden MOS Design GmbH, Dresden	EUR	20,00	625	216
Ausland				
Elmos Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	91.643	11.804
Elmos Advanced Packaging B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	-1.175	-2.133 ²
ELMOS Design Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	-2.425	-735 ²
ELMOS Quality Services B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	12.298	318 ²
European Semiconductor Assembly (Eurasem) B.V., Nijmegen (NL)	EUR	100,00	31.547	0 ²
Micro Systems on Silicon (MOS) Limited, Pretoria (Südafrika)	ZAR	67,60	-592	-559 ²
EL-MOS France S.A., Nanterre (F)	EUR	100,00	2.238	1.166
Elmos USA Inc., Michigan (USA)	USD	100,00	--	-- ³
ELMOS California Inc., Milpitas (USA)	USD	100,00	-296	-24 ²
ELMOS N.A. Inc., Farmington Hills (USA)	USD	100,00	-3.005	912 ²
Silicon Microstructures Inc., Milpitas (USA)	USD	100,00	-3.889	-8.392 ²

¹ Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen zum 31. Dezember 2007.

² Es handelt sich um mittelbaren Anteilsbesitz der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund.

³ Es liegt bislang kein Jahresabschluss der Gesellschaft vor.

Vorräte

Im Geschäftsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf Vorratsvermögen in Höhe von TEUR 800 vorgenommen.

Forderungen und Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben bis auf einen Betrag von TEUR 97 (Vj. TEUR 102) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen das verbundene Unternehmen IndustrieAlpine Bauträger GmbH, München, wurden in Höhe von TEUR 871 wertberichtigt.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind aktivierte Forderungen auf Erstattung von verauslagten Entwicklungskosten in Höhe von TEUR 233 (Vj. TEUR 418) enthalten.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Hierin ist ein Disagio in Höhe von TEUR 93 enthalten.

Eigenkapital

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2007 aus 19.414.205 auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von EUR 19.414.205,00 ist voll eingezahlt.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu EUR 9.650.000,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).

Das Grundkapital ist um EUR 885.795,00, eingeteilt in 885.795 nennwertlose Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I).

Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogramms der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Ein Mitarbeiter hat im Jahr 2007 vom Optionsrecht zum Aktienerwerb Gebrauch gemacht, was zur Ausgabe von 400 nennwertlosen Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 EUR, die auf den Inhaber lauten, geführt hat und eine Kapitalerhöhung des Grundkapitals aus bedingtem Kapital zur Folge hatte. Die Kapitalrücklage erhöhte sich insgesamt um EUR 2.748,00 mit EUR 6,87 je Aktie.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu EUR 5.000.000,00, eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus bis zum 9. Mai 2012 durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittelbare inländische oder ausländische 100-prozentige Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft gemäß der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 10. Mai 2007 begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren inländischen oder ausländischen 100-prozentigen Beteiligungsgesellschaften bis zum 9. Mai 2012 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu nominal EUR 930.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durch Ausgabe von bis zu 930.000 neuen Stückaktien ohne Nennwert mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien und nur zur Einlösung von Bezugsrechten durchgeführt, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der ELMOS Semiconductor AG in dem Zeitraum vom 1. Oktober 2004 bis zum 26. April 2009 gewährt werden. Der Vorstand – und soweit es die Mitglieder des Vorstands betrifft der Aufsichtsrat – wird angewiesen, im Rahmen dieses Aktienoptionsplans 2004 bis zu 930.000 Stück Bezugsrechte auf je eine Aktie der Gesellschaft an die unten bezeichneten Berechtigten unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in jährlichen Tranchen auszugeben. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der ELMOS Semiconductor AG aus dem bedingten Kapital Bezugsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Bezugsrechte hiervon innerhalb der Ausübungsfrist Gebrauch machen.

Jedes Bezugsrecht berechtigt zum Bezug einer Stückaktie ohne Nennwert mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00.

Es bestehen Bezugsrechte gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG aus einem Aktienoptionsprogramm für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter zum Erwerb von 582.380 Aktien.

Gratisaktien-Programm (Stock Awards)

Im Jahr 2007 wurde erstmalig ein Gratisaktien-Programm (Stock Awards) aufgelegt. Die Stock Awards wurden an besonders verdiente Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Vorstands in Anerkennung für die im Vorjahr erbrachte Leistung vergeben. Die Gewährung dieser Awards soll zum einen die Verbundenheit von ELMOS mit ihren Leistungsträgern zeigen und zum anderen als Motivation für das Engagement und die Leistungsbereitschaft verstanden werden.

Das Stock Awards Programm 2007 umfasst 29.000 Aktien und entspricht 0,15 % des Grundkapitals. Diese wurden zuvor an der Börse im Rahmen der Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien zurück erworben. Für die Stock Awards gilt eine Haltefrist von zwei Jahren; davon ausgenommen ist ein Verkauf von Aktien in der erforderlichen Anzahl, so dass die Steuern, die auf den geldwerten Vorteil der Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Vorstands entstehen, beglichen werden können. ELMOS plant auch für die kommenden Jahre ein ähnliches Stock Awards Programm.

Die Aktien wurden zwischen dem 16. August 2007 und 23. August 2007 zum Preis von EUR 7,23 je Aktie zuzüglich Provision erworben (gesamt TEUR 212) und bis zum 31. Dezember 2007 vollständig an die Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Vorstands ausgegeben.

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von TEUR 44.938 enthalten; im Übrigen verweisen wir auf den unten stehenden Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen wurden für ehemalige Mitglieder des Vorstandes bzw. deren Hinterbliebenen gebildet.

Die Steuerrückstellungen betreffen Ertragsteuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Tantiemen, Berufsgenossenschaftsbeiträge, Garantieleistungen, Lizenzen, nachkommende Rechnungen, Aufsichtsratsvergütungen und Altersteilzeitansprüche gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel im Einzelnen dargestellt.

Die Verbindlichkeiten enthalten keine gegenüber Gesellschaftern.

Verbindlichkeitspiegel in TEUR

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit				gesamt 31.12.2006
	gesamt 31.12.2007	unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.115	1.115	10.000	30.000	31.603
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0	69
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.819	6.819	0	0	7.632
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.314	35.314	0	0	23.342
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.786	1.786	0	0	15
6. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	939	939	0	0	
- davon aus Steuern (Vorjahr)	679	(1.185)	(146)	(0)	(1.331)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr)	2	508	83	88	
		(377)	(0)	(0)	(377)
		2	0	0	
		(0)	(0)	(0)	(0)

Angabe von Art und Form der Sicherheiten

Ein Darlehen über TEUR 20.000 ist durch eine auf TEUR 12.500 betragsmäßig beschränkte Bürgschaft der WestLB AG, Düsseldorf, gesichert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind, bis auf branchenüblich verlängerte Eigentumsvorbehalte von Lieferanten im Wesentlichen nicht besichert. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ebenfalls nicht besichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft hat eine Bürgschaft für eine Kreditlinie in Höhe von USD 2.000.000,00 übernommen, welche einem verbundenen Unternehmen gewährt wurde. Zum Abschlussstichtag hat das verbundene Unternehmen die Kreditlinie nicht in Anspruch genommen. Für das verbundene Unternehmen wurde im Januar 2008 zusätzlich für einen Zeitraum von zwölf Monaten eine Patronatserklärung abgegeben.

Die Dresden MOS Design GmbH, Dresden, (kurz DMOS) hat von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) einen Zuwendungsbescheid erhalten, wonach die Sächsische Aufbaubank für den Bau eines Bürogebäudes sowie für die Anschaffung von Maschinen, Einrichtungen und immateriellen Wirtschaftsgütern einen Zuschuss über TEUR 1.874 bewilligt. Die Gesellschafter der DMOS haben gleichzeitig eine Höchstbetragsbürgschaft in Höhe des Zuschusses gegenüber der SAB abgeben müssen. ELMOS verpflichtet sich gegenüber den Gesellschaftern und der DMOS, diese im Falle einer Inanspruchnahme auf eine Rückerstattung durch die zuschussgewährende Stelle freizustellen. Die Freistellung beinhaltet den Zuschuss in Höhe von TEUR 1.874 zuzüglich Zinsen und etwaiger Nebenforderungen. Die Haftungsfreistellung wird wirksam, falls der geltend gemachte Erstattungsanspruch darauf beruht, dass ELMOS durch die Ausübung der ihr mit notariellen Urkunden vom 1. Oktober 2002 und 23. Januar 2004 unterbreiteten unwiderruflichen Angebote auf Erwerb von Teilgeschäftsanteilen in förderschädlicher Weise an der DMOS beteiligt wird.

Derivative Finanzinstrumente

Die Gesellschaft hat einen Bonus Zinssatz-Swap für einen Nominalbetrag in Höhe von TEUR 20.000 und einer Laufzeit vom 14. April 2003 bis zum 14. April 2008 abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrages ist der Tausch eines Festzinssatzes in Höhe von 5,250 % p. a. gegen einen variablen Zinssatz in Höhe der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR-Telerate) für 3-Monatsgelder.

Zum Stichtag wurde das Finanzderivat zum Marktwert von EUR 0,00 bewertet. Eine Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften war nicht zu bilden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat Leasingverträge für das Betriebs- und Verwaltungsgebäude, das Mitarbeiterzentrum, das Parkhaus sowie für ein weiteres Bürogebäude abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2014, 2020, 2021, 2022 und 2030 erstrecken. Außerdem hat die Gesellschaft Leasingverträge für technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2008 und vereinzelt bis 2011 erstrecken. Daneben bestehen Leasingverträge für den Fuhrpark, Büromaschinen und technische Anlagen und Maschinen in betriebsüblichem Umfang.

Die Gesellschaft hat einen Vertrag über gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie zur Nutzung einer Produktionslinie mit einer Laufzeit bis 2016 abgeschlossen.

Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden nichtkündbaren oben genannten Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

	<u>TEUR</u>
2008	20.771
2009	17.312
2010	16.467
2011	11.844
2012	10.696
Folgejahre (gesamt)	56.053

Aus erteilten Investitionsaufträgen besteht ein Bestellobligo von TEUR 5.028.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2007 <u>TEUR</u>	2006 <u>TEUR</u>
- nach Sparten		
Produktion	154.331	139.661
Entwicklung	3.533	3.190
Sonstiges	<u>488</u>	<u>285</u>
Nettoumsatzerlöse	<u><u>158.352</u></u>	<u><u>143.136</u></u>
- nach Regionen		
Inland	61.446	54.836
Übrige EU-Länder	58.244	57.051
USA	11.928	13.246
Übrige Länder	<u>26.734</u>	<u>18.003</u>
Nettoumsatzerlöse	<u><u>158.352</u></u>	<u><u>143.136</u></u>

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus Währungsdifferenzen (TEUR 427), Erträge aus Anlagenabgängen (TEUR 18), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 8), Erträge aus Projektförderungen (TEUR 298) und Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 24). Darüber hinaus werden im Wesentlichen Erträge aus privater Pkw-Nutzung (TEUR 313), Erhöhung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung (TEUR 285), Erstattungen sonstiger Steuern (TEUR 470), Mieterträge (TEUR 188) und Weiterbelastungen an das IMS (TEUR 1.528) ausgewiesen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den periodenfremden Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen aus Garantieleistungen (TEUR 900), sowie das Jahr 2006 betreffende Entwicklungsgutschriften (TEUR 214) und Nachbelastungen Vorjahre (TEUR 178).

Honorare für Abschlussprüfer

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar für Abschlussprüfer gliedert sich auf in die Bereiche Abschlussprüfung (TEUR 95), sonstige Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen (TEUR 217), Steuerberatungsleistungen (TEUR 134) sowie sonstige Leistungen (TEUR 1).

Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer, Duisburg, Diplom-Physiker, pens. Institutsleiter (Vorsitzender)
Dr. Burkhard Dreher, Dortmund, Diplom-Volkswirt (stellvertretender Vorsitzender)
Jörns Haberstroh, Kerken, Diplom-Ökonom
Dr. Peter Thoma, Unterschleißheim, Diplom-Physiker
Jutta Weber, Tarrytown, New York, Diplom-Pädagogin
Dr. rer. nat. Klaus Weyer, Diplom-Physiker (seit 1. Januar 2007)

Herr Prof. Dr. Günter Zimmer übt zwei weitere Aufsichtsratsmandate (Siltronic AG, Dolphin Intégration S.A.), Herr Dr. Burkhard Dreher weitere drei (GfV AG, EKO Stahl GmbH, Vattenfall Europe Mining AG), Herr Jörns Haberstroh weitere zwei (Ehlebracht AG, 3M-Quante AG), und Herr Dr. Peter Thoma zwei weitere Mandate aus (Behr GmbH & Co. KG bis zum 1. Juli 2007 und Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG). Herr Dr. Weyer übt zwei Aufsichtsratsmandate aus (Aufsichtsrat der Paragon AG, Projektbeirat der MST Dortmund).

Vorstand

Diplom-Physiker Dr. rer. nat. Anton Mindl, Lüdenscheid (Vorsitzender)
Diplom-Ingenieur Dr. rer.-nat. Frank Rottmann, Dortmund
Diplom-Ingenieur Reinhard Senf, Iserlohn
Diplom-Volkswirt Nicolaus Graf von Luckner, Oberursel

Gesamtbezüge des Vorstands

Die Bezüge des Vorstands teilen sich in fixe Bezüge und variable, erfolgsorientierte Bezüge auf, die sich prozentual aus dem Ergebnis des Konzerns vor Steuern ableiten. Demnach betragen die Bezüge des Vorstands für 2007 insgesamt TEUR 1.905. Hiervon entfallen auf den fixen Bestandteil TEUR 1.655 und auf den variablen Teil TEUR 185. Aus dem Gratisaktien-Programm (Stock Awards) wurden den Vorstandsmitgliedern, 8.900 Aktien mit einem Zeitwert zum Zeitpunkt ihrer Gewährung in Höhe von insgesamt TEUR 65 übertragen.

In der Hauptversammlung vom 19. Mai 2006 wurde mit einer $\frac{3}{4}$ -Mehrheit beschlossen, die Angaben gemäß § 285 I Nr. 9a Satz 5 - 9 HGB für die folgenden fünf Jahre zu unterlassen.

Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihrer Hinterbliebenen betragen im Geschäftsjahr 2007 TEUR 79. Ferner wurden Versicherungsprämien in Höhe von TEUR 200 entrichtet und eine Pensionsrückstellung in Höhe von TEUR 1.838 gebildet.

Die Mitglieder des Vorstandes halten die folgende Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

Aktienbestand Vorstand

Dr. Anton Mindl	12.225 Stück	0 Optionen
Dr. Frank Rottmann	1.975 Stück	6.200 Optionen
Reinhard Senf	3.923 Stück	40.000 Optionen
Nicolaus Graf von Luckner	2.975 Stück	0 Optionen

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die fixen Bezüge (inkl. Spesen und Auslagen) des Aufsichtsrats beliefen sich für 2007 insgesamt auf TEUR 92, es wurde keine variable Vergütung gezahlt.

An Aufsichtsratsmitglieder wurden in 2007 keine Aktienoptionen ausgegeben.

Für sonstige Dienstleistungen – insbesondere Beratungen – vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2007 TEUR 377.

Die folgenden Mitglieder des Aufsichtsrates halten die angegebene Anzahl an Aktien der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund:

Aktienbestand Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer	0 Stück	0 Optionen
Dr. Burkhard Dreher	1.900 Stück	0 Optionen
Jörns Haberstroh	3.956 Stück	0 Optionen
Dr. Peter Thoma	9.200 Stück	40.000 Optionen
Jutta Weber	200 Stück	0 Optionen
Dr. Klaus Weyer	10.000 Stück	25.000 Optionen

Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte

Die folgenden meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte fanden in 2007 statt:

- Dr. Anton Mindl: Kauf von 1.000 Aktien zu EUR 7,55 am 28. September 2007
Kauf von 1.000 Aktien zu EUR 7,52 am 7. November 2007
Übertragung von 2.975 Aktien zu EUR 7,25 am 8. November 2007
- Herr Nicolaus Graf von Luckner:
Übertragung von 1.975 Aktien zu EUR 7,25 am 8. November 2007
- Dr. Frank Rottmann:
Übertragung von 1.975 Aktien zu EUR 7,25 am 8. November 2007
- Herr Reinhard Senf:
Übertragung von 1.975 Aktien zu EUR 7,25 am 8. November 2007

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Gewerbliche Arbeitnehmer	285	254
Angestellte (inkl. Teilzeitkräfte umgerechnet auf Vollzeit)	<u>429</u>	<u>395</u>
	<u><u>714</u></u>	<u><u>649</u></u>

Konzernverhältnisse

Die ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, befindet sich im mittelbaren Mehrheitsbesitz der EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, die nach § 290 Abs. 2 Nr. 2 HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist. Die Aufstellung eines Konzernabschlusses durch die EFH ELMOS Finanzholding GmbH, Dortmund, zum 31. Dezember 2007 erfolgte bislang nicht.

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt (in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat) vor, den Bilanzgewinn von EUR 39.621.311,85 auf neue Rechnung vorzutragen.

Erklärung gemäß § 161 AktG zum Corporate-Governance-Kodex

Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, haben die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung abgegeben und den Aktionären zugänglich gemacht.

Dortmund, im März 2008

Der Vorstand

Dr. Anton Mindl Nicolaus Graf von Luckner Dr. Frank Rottmann Reinhard Senf

Lagebericht für 2007

Geschäft und Rahmenbedingungen

Geschäftstätigkeit

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte, zumeist anwendungsspezifische, mikroelektronische Schaltkreise, vornehmlich für die Automobilindustrie. Auch im Jahr 2007 entfielen rund 90% vom Umsatz auf dieses Marktsegment. Seit ihrer Gründung hat sich ELMOS eine führende Marktposition als Halbleiterhersteller im europäischen Markt für Automobilelektronik erarbeitet. Basierend auf einer Studie des Marktforschungsinstituts Gartner Dataquest aus dem März 2007 wird ELMOS als die weltweite Nummer zwei (im Vorjahr Nummer drei) im Segment der ASICs (Application Specific Integrated Circuits) für den Automobilmarkt nach STMicroelectronics aufgeführt. Die direkten Wettbewerber AMI Semiconductor und Melexis folgen auf den Plätzen vier und fünf.

ELMOS-Chips werden von nahezu allen europäischen sowie zahlreichen amerikanischen und asiatischen Fahrzeugherstellern eingesetzt. Stetig wachsende Anforderungen an die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und die Umweltverträglichkeit eines Kraftfahrzeugs sowie an Sicherheit und Komfort führen zu immer mehr Elektronik im Auto. Halbleiterbausteine von ELMOS sind ideal geeignet, solche Systeme kompakt, zuverlässig und kostengünstig aufzubauen.

Automobile Neuprojekte benötigen in der Regel zwei bis drei Jahre Entwicklungszeit, bevor sie für etwa fünf bis acht Jahre in Serie produziert werden. Teilweise verlängert sich diese Produktionszeit erheblich, wenn Autohersteller eine ähnliche technische Plattform in einer Familie von neuen Modellen einsetzen. Zum Zeitpunkt des Gewinns eines Neuprojekts werden in der Regel die Preise in Abhängigkeit von den geplanten Mengen für die gesamte Projektlaufzeit kalkuliert.

Neben dem automobilen Markt ist ELMOS zudem im Industrie- und Konsumgüterbereich tätig und liefert kundenspezifische Schaltkreise z.B. für Anwendungen in Haushaltsgeräten, Fotoapparaten, Installations- und Gebäudetechnik und Maschinensteuerungen. Dieser nicht-automobile Bereich hat im vergangenen Jahr, wie in den Vorjahren, rund 10% des Umsatzes ausgemacht.

Seit mehr als 20 Jahren bedient ELMOS Nischenmärkte mit eigenem Know-how. Es ist die Strategie, zum einen durch die kundenspezifische Produktentwicklung und zum anderen durch eine konsequent an den Marktbedürfnissen ausgerichtete Fertigungstechnologie zu überzeugen. So entwickelt ELMOS derzeit noch überwiegend Produkte im Kundenauftrag für eine spezielle Anwendung und produziert diese exklusiv für den jeweiligen Kunden.

Neben den kundenspezifischen Schaltkreisen, die mehr als 90% der Produkte umfassen, verfügt ELMOS zudem über ein Portfolio von anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) sowie von mikromechanischen Sensoren. ELMOS produziert ASICs und ASSPs bislang fast ausschließlich in den eigenen Produktionsstätten (Wafer-Fabs) in Dortmund und Duisburg.

Sowohl durch die automobilgerechte Hochvolt-CMOS-Technologie als auch durch die systemgerechte Integration von analogen und digitalen Funktionen mit On-Chip-Treiberleistungen unterscheidet sich ELMOS von den meisten Wettbewerbern.

Mikromechanische Bauelemente (MEMS) entwickeln, produzieren und vertreiben wir bei unserer Tochtergesellschaft Silicon Microstructures (SMI), welche zu den Technologieführern im Bereich der hochpräzisen Drucksensoren in Silizium zählt. Mit einer eigenen Fertigung in Kalifornien verfügt SMI über stabile Serienfertigungseinrichtungen und -fähigkeiten. Darüber hinaus unterstützt die produzierende Tochterfirma ELMOS Advanced Packaging B.V. (ELMOS AP) mit Sitz in Nijmegen, Niederlande, das Technologie- und Produktportfolio. ELMOS AP entwickelt und fertigt Spezialgehäuse für elektronische Halbleiterkomponenten und Sensoren. Die Fabrik in Nijmegen entspricht dem modernsten Stand der Technik. ELMOS AP wurde im Geschäftsjahr 2007 komplett auf kunden- und applikationsspezifische Spezialgehäuse ausgerichtet, die sich teilweise durch patentiertes Know-how vom Wettbewerb unterscheiden. Neben der konzerninternen Assemblierung fertigt ELMOS AP auch Spezialgehäuse für Drittkunden.

Die Entwicklung und Vermarktung von anwendungsspezifischen, mikro-mechatronischen Modulen, realisiert durch ELMOS Microsystems, runden die Produktpalette ab. Diese Module kombinieren die Fähigkeiten der ELMOS-Gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden Halbleiterbauelementen, mikromechanischen Sensoren und funktionalem Gehäuse. Damit kann der Kunde kostengünstige Systemlösungen realisieren.

Strategie

Die Strategie von ELMOS umfasst als Kernelemente den Ausbau der starken Position im automobilen ASIC-Geschäft, den verstärkten Vertrieb von ASSPs zur Ergänzung des existierenden Produkt- und Kundenportfolios, die Vereinbarung von Kooperationen zur Reduzierung der Investitionen und Ergänzung des existierenden Technologie- und Produktportfolios, die Etablierung des Mikrosystem-Geschäfts als Wachstumssäule des Unternehmens sowie die stärkere Bedienung der Konsumgüter- und Industriemärkte. Regional haben wir die Zielsetzung, stärker am Wachstum in Asien zu partizipieren. Im Berichtsjahr konnten wir bei der Umsetzung der Strategie erhebliche Fortschritte erzielen.

Automobiles ASIC-Geschäft

Der Gewinn von wichtigen Folgeaufträgen für kundenspezifische Halbleiter im Automobil im Jahr 2007 unterstreicht den Ausbau der starken Position im automobilen ASIC-Geschäft. Die Kernkompetenzen im Bereich der effizienten Motoransteuerung für Klimaanlage sowie verschiedene Airbag-ICs standen dabei im Mittelpunkt. Auftraggeber sind u.a. langjährige Kunden aus der Automobilindustrie. Diese Folgeaufträge bestätigen das Vertrauen der Kunden in eigens entwickelte Halbleiterlösungen. Das Volumen der Aufträge stellt das mittelfristige Wachstum der Gesellschaft auf eine solide Basis.

Die Pflege enger Kundenbeziehungen und deren Intensivierung sind für uns nach wie vor von hoher Bedeutung. So haben wir im Berichtsjahr bereits zum wiederholten Mal eine In-house Kundenveranstaltung durchgeführt, bei der zahlreiche Vertreter der Automobilindustrie aktuelle Trends der Fahrzeug-Elektronik präsentierten. Unter dem Motto „Mega-Trends und Nischen: Standardisierung, Modularisierung und Differenzierung durch Elektronik“ haben renommierte Referenten von Audi, BMW, Daimler, Ford, Hyundai-Kia, Opel, VW und Tyco Electronics AMP vorgetragen.

ASSPs

Im Jahr 2007 haben wir die Entwicklung und den Vertrieb von Applikations-Standards (ASSPs) stark vorangetrieben. Hierbei fließen insbesondere patentrechtlich geschützte Verfahren wie HALIOS® (High Ambient Light Independent Optical System) und VirtuHall® ein, die für ELMOS und die Kunden Wettbewerbsvorteile bringen. Eine derartige Familie von Applikations-Standards erlaubt dem Anwender die schnelle und einfache Realisierung von intelligenten Lösungen, z.B. für Sensor- bzw. Antriebsanwendungen.

Bei der Entwicklung der ASSPs fokussieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen in den Bereichen „Sense“, „Drive“, „Connect“ und „Supply“. Im Bereich „Sense“ entwickeln wir neue Sensorelemente, Sensorauswerte-ICs und Mikrosysteme für verschiedene physikalische Messgrößen. Das ELMOS-eigene VirtuHall® Prinzip zur effizienten Ansteuerung von EC-Motoren schlägt sich in einer ganzen IC-Familie für den Bereich „Drive“ mit verschiedenen Derivaten nieder. Für die Produktgruppe „Connect“ stehen zahlreiche standardisierte Bus-ICs zur Verfügung, die sowohl im Auto als auch in der Industrie vermehrt eingesetzt werden. Für die Applikationsgruppe „Supply“ werden neue Schaltungskonzepte in die Tat umgesetzt, um unseren Kunden hoch effiziente DC/DC-Wandler – beispielsweise für LED-Beleuchtungen in Fahrzeugen oder in Gebäuden – anzubieten. Die Produkte sind für einen Einsatz sowohl in Automobil- wie auch in Industrie- und Konsumgüterapplikationen geeignet.

Weitere im Jahr 2007 durchgeführte Maßnahmen, die den gestiegenen Stellenwert der ASSPs für ELMOS unterstreichen, sind die Verbreiterung der Distributorenbasis, die Neugestaltung der Webseite, die im Produktbereich nun eine Suche nach ASICs oder ASSPs ermöglicht, sowie der neu aufgelegte, mit 64 Produkten auf über 130 Seiten deutlich erweiterte Standard-Produktkatalog.

Kooperationen

Um langfristig ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio anzubieten und gleichzeitig dauerhaft einen positiven Free Cash Flow zu generieren, ist es die Strategie von ELMOS, mit Partnern zu kooperieren und dadurch die eigenen Fähigkeiten sinnvoll zu ergänzen. Dies ermöglicht gleichzeitig eine Reduktion der Investitionen bzw. Entwicklungsaufwendungen für ELMOS.

ELMOS verfolgt sowohl den Ansatz sogenannter Zwei-Chip-Lösungen, bei denen Chips von zwei unterschiedlichen Herstellern in einem Package assembliert werden können, als auch den der Fremdfertigung, bei der i.d.R. große Halbleiterfoundries in von ELMOS nicht angebotenen Technologien nach unseren Konstruktionsplänen produzieren. Beispielsweise haben wir in 2007 mit einer taiwanesischen Foundry funktionsfähige Chips für ein Konsumgüterprodukt realisiert. Darüber hinaus haben wir Anfang 2008 mit einem Partner einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Dabei werden wir zusammen mit dem koreanischen Unternehmen MagnaChip einerseits eine neue Technologie entwickeln und andererseits dort fertig prozessierte Wafer beziehen. Wir können dadurch mittelfristig unseren Investitionsbedarf reduzieren und flexibler auf stark schwankende Stückzahlen reagieren.

Darüber hinaus haben wir in 2007 unsere seit vielen Jahren bewährten Partnerschaften mit unseren Packaging-Dienstleistern in Südostasien weiter intensiviert. So wurde Mitte 2007 die Verlagerung der Standard-Chip-Verpackungen von ELMOS Advanced Packaging nach Asien abgeschlossen.

Mikrosysteme

ELMOS ist eines der wenigen Unternehmen, welches komplette Mikrosysteme, bestehend aus ASICs und MEMS in einem kundenspezifischen Package, vollständig entwickeln und produzieren kann. Mit dieser Fähigkeit hebt sich ELMOS klar von seinen Wettbewerbern ab und offeriert einen einzigartigen Vorteil.

In 2007 hat der Vorstand bei SMI eine neue Geschäftsführung eingesetzt, um zukünftig die Marktchancen für Mikrosysteme besser und zuverlässiger zu nutzen. Zudem wurde ein Restrukturierungs- und Ergebniskorrekturbedarf für 2007 festgestellt. Dies hatte auch Auswirkungen auf den Standort in den Niederlanden. Aufgrund von verspäteten SMI-Produktanläufen musste in den Niederlanden die Struktur angepasst werden.

Neue Märkte

Nach der Gründung von ELMOS Industries Ende 2006 wurden in 2007 die Grundlagen dafür geschaffen, dass die nicht-automobilen Märkte, d.h. Industrie- und Konsumgütermärkte, mittelfristig einen Anteil von 20% bis 30% des Gesamtumsatzes ausmachen können.

So sind im Berichtsjahr bereits einige ASIC-Projekte aus dem Bereich der Heizungssteuerung, Industrie-Bus-Applikation, Industriesteuerung, etc. entstanden, die teilweise bereits in Serie produziert und an die Kunden ausgeliefert werden. Weitere ASIC- und ASSP-Projekte werden derzeit mit mehreren Kunden verhandelt, so dass eine deutliche Steigerung des Umsatzes in diesem Segment in den nächsten Jahren erwartet wird.

Mit dem Gewinn eines Auftrags von einem großen japanischen Elektronikkonzern konnte im Berichtsjahr ein signifikanter Erfolg auf dem asiatischen nicht-automobilen Markt verzeichnet werden. Das Produkt ist ein neuer Chip basierend auf unserem patentierten HALIOS®-Prinzip, welches u.a. die kontaktlose dreidimensionale Erfassung von Gegenständen oder Bewegungen ermöglicht. Die damit realisierbaren berührungslosen Schalter sollen 2008 in erste Applikationen aus dem Konsumgüterbereich, beispielsweise in Fernbedienungen, MP3-Playern, Telefonen und Computer-Peripheriegeräten, verbaut werden.

Rahmenbedingungen des automobilen Halbleitermarkts

Der für EL MOS wichtigste Markt ist der der Halbleiterchips für die Automobilindustrie. Dieser Markt stellt einen Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie dar. Er umfasst weltweit einen Anteil von rund 7% des gesamten Halbleitermarkts. Bedingt durch den Einfluss der relativ konstanten Automobilproduktion und des zunehmenden Anteils der Elektronik im Fahrzeug weist der automobilen Halbleitermarkt eine deutlich höhere Stabilität auf als der globale Halbleitermarkt, welcher hauptsächlich durch die Entwicklungen bei Speicher- und Kommunikationschips geprägt ist. Spezielle Differenzierungsmerkmale des automobilen Halbleitermarkts sind die für die Halbleiterbranche untypisch lange Produktlebensdauer und die dadurch bedingten langen Lieferzeiträume von teilweise mehr als zehn Jahren. Zudem unterscheidet sich der Markt durch langfristige Kunden-Lieferanten-Beziehungen und die sehr hohen Qualitätsanforderungen sowie robuste Halbleitertechnologien.

In 2007 war die Basis unseres Kerngeschäfts – der Automobilssektor – in Westeuropa, insbesondere in Deutschland, und in den USA schwach. Dies ist u.a. auf den Ölpreis, die in den USA ausgelöste Kreditkrise und deren Einfluss auf das Konsumverhalten sowie den schwachen Dollarkurs zurückzuführen. Dennoch konnten einige deutsche Automobilhersteller signifikante Erfolge im Export erzielen.

Basierend auf einer Studie des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI) wird in dem Zeitraum von 2006 bis 2011 insgesamt mit einer jährlichen Zunahme der Automobilproduktion um 4% gerechnet. Dabei schneiden Nordamerika und Deutschland mit mittleren jährlichen Produktionszunahmen zwischen 1% und 2% am schwächsten ab. Für Osteuropa und Asien werden signifikante Produktionszuwächse, zum Teil im zweistelligen Bereich, erwartet.

Während im Jahr 1985 bei einem PKW der Mittelklasse der Anteil elektronischer Systeme an den gesamten Produktionskosten nur 3% ausmachte, liegt heute dieser Wertanteil bereits bei etwa 22% des Produktionswertes. Gleichzeitig beträgt der Wert der Halbleiter etwa 12%. Aufgrund von zunehmender Integration elektronischer Systeme und wegen neuen Technologien wird erwartet, dass der Halbleiteranteil überproportional steigen wird. So soll der Wertanteil aller elektronischen Steuerungen im Fahrzeug bis Mitte der 2020er Jahre auf etwa 30% und der der Halbleiterbauelemente auf über 20% der Produktionskosten wachsen. Für die nächsten Jahre werden von verschiedenen Marktforschungsinstituten Wachstumsraten von 7% bis 8% pro Jahr für den automobilen Halbleitermarkt erwartet.

Treibende Elemente dieses Wachstums sind neben der stark weiter wachsenden Zahl von Dieselfahrzeugen mit aufwendiger Steuerung auch die neuen Benzinmotoren mit Hochdruck-Direkteinspritzung. Dazu kommen immer strenger werdende gesetzliche Abgasvorschriften, welche den Bedarf an aufwendigeren elektronischen Systemen verursachen. Großes Wachstum zeigen auch Systeme, die dem Personenschutz dienen, wie beispielsweise Fahrzeugstabilisierungssysteme.

Der von ELMOS maßgeblich adressierte Markt ist wiederum nur ein Teil des automobilen Halbleitermarkts, nämlich der der vorwiegend kundenspezifischen Halbleiter (ASICs), und der applikationsspezifischen Halbleiter (ASSPs). Wegen der vergleichsweise geringen Jahresstückzahlen stehen diese nicht im Fokus der großen Halbleiterhersteller, welche eine hohe Auslastung für ihre großen Produktionskapazitäten benötigen. Weitere Differenzierungsmerkmale des ASIC-Geschäftes sind sehr enge Lieferbeziehungen des Kunden zu einem einzelnen ASIC-Hersteller, die unter anderem aus dem Wunsch des Kunden nach Schutz des eigenen Know-hows entstehen. ASSPs unterscheiden sich insofern von ASICs, als dass diese von mehreren Kunden eingesetzt werden können, jedoch genau wie ASICs auf eine bestimmte Applikation zugeschnitten sind. Wettbewerber von ELMOS bei typischen ASIC- und ASSP-Projekten mit mittleren Stückzahlen sind Firmen ähnlicher Größe wie AMI Semiconductor, Melexis, austria micro systems und Micronas. Bei sehr großen Stückzahlen steht ELMOS auch in Konkurrenz zu Großproduzenten wie Infineon, STMicroelectronics und Freescale.

Im Jahr 2007 hat sich der Trend der Vorjahre fortgesetzt. Die Konsolidierung im Automobilmarkt hält unvermindert an, die Anzahl der Zulieferer sinkt. Die durchschnittlichen Volumina der Projekte steigen an und damit auch der Preisdruck. Dieser wird von den Automobilherstellern in Form von Kostensenkungsprogrammen an die so genannten „Tier 1“ Hersteller, die Zulieferer der ersten Reihe, weitergegeben. Diese reichen den Preisdruck bei der Verhandlung von Neuprojekten an ihre Zulieferer weiter.

Produktion

In 2007 wurden insgesamt rund 150 Millionen Chips produziert. Dabei hat sich der Trend der Vorjahre, steigende Anforderungen an die Produkte und damit deren Komplexität, gemessen an der Anzahl der zu strukturierenden Ebenen (Layer), weiter fortgesetzt.

Die 2007 an Kunden ausgelieferten ASICs und ASSPs wurden nach wie vor überwiegend am Hauptstandort Dortmund auf der 150mm-Wafer-Linie (entspricht 6-Zoll) produziert. Die 200mm-Wafer-Linie (entspricht 8-Zoll) am Produktionsstandort Duisburg wurde hochgefahren. Die Fertigung wurde am Jahresende 2007 noch nicht in der vollen Kapazität genutzt. Um Qualität und Stabilität von Produkten und Prozessen zu gewährleisten, haben wir in der zweiten Hälfte des letzten Quartals 2007 die Wafereinstellung nicht weiter gesteigert. Die zweite Halbleiterproduktionsstätte ist sowohl zur Absicherung der Versorgung als auch für die Nutzung der Kostensenkungspotenziale aufgrund des größeren Waferdurchmessers bedeutend.

Erfreulich ist, dass im Laufe des Jahres 2007 ausreichend Kundenfreigaben zur Füllung der vorhandenen Kapazität am Standort Duisburg gewonnen werden konnten. Die in Duisburg gefertigten Produkte haben im Berichtsjahr einen wichtigen Beitrag zur Kundenversorgung geleistet. In 2008 wird der Ausbau in Duisburg fortgesetzt. Insbesondere werden Einzelinvestments zur Beseitigung von Maschinenengpässen und Schaffung von Redundanzen zur Volumenstabilisierung vorgenommen.

Der Fertigungsanteil von 8-Zoll-Wafern aus Duisburg soll weiter hochgefahren werden, so dass die nötige Kapazität für die Erweiterung und Umstellung der Fertigung am Hauptsitz in Dortmund planmäßig zur Verfügung stehen wird. Mitte 2008 soll dann mit der schrittweisen Umstellung der Produktionslinie in Dortmund von 6-Zoll auf 8-Zoll-Wafer begonnen werden. Das ist ein weiterer wichtiger Baustein zur Erweiterung der Fertigungskapazitäten und zur Steigerung der Produktivität. Fertigungsflächen für die schrittweise Umstellung eines Teils der Dortmunder Waferfertigung auf 200mm-Waferdurchmesser sind vorhanden.

Im Jahresdurchschnitt 2007 lag die Maschinenkapazität insgesamt bei rund 580 Waferstarts pro Tag (6-Zoll-waferäquivalent). Dies entspricht einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Jahresende 2006 (31. Dezember 2006: 480 Waferstarts pro Tag), welcher durch den Ausbau der Fertigungslinie Duisburg begründet ist. Die durchschnittliche Ausnutzung mit rund 550 Waferstarts pro Tag ist ebenfalls stark gestiegen (2006: rund 430 Waferstarts pro Tag).

Neben den eigenen Fertigungsstätten soll zukünftig die erforderliche Kapazität auch durch Auftragsfertigungen (Foundries) bereitgestellt werden. Hierzu wurde nach Ende des Berichtsjahres bekannt gegeben, dass wir mit dem koreanischen Unternehmen MagnaChip kooperieren werden. Diese Kooperation ermöglicht es ELMOS, auch auf stärker schwankende Nachfrage flexibel reagieren zu können. Im Berichtsjahr wurde bereits mit einer taiwanesischen Foundry ein Konsumgüterprojekt gestartet und Prototypen produziert. Die Möglichkeit der Produktion bei einem Foundry-Partner soll insbesondere für ASSPs und für Produkte im Industrie- und Konsumgüterbereich wahrgenommen werden.

Das Standard-Assembly Geschäft wurde planmäßig Mitte 2007 komplett zu langjährigen Partnern nach Südostasien ausgelagert. Somit konzentriert sich die niederländische Tochtergesellschaft ELMOS Advanced Packaging nun schwerpunktmäßig auf die Tätigkeitsfelder Gehäuseentwicklung und Fertigung von Sondergehäusen für mikromechanische Systeme (MEMS), Waferbearbeitung und Verpackung (Tape & Reel).

Forschung und Entwicklung

Die immer intensivere Nutzung von elektronischen Komponenten im Automobil führt zu kontinuierlich steigenden Anforderungen der Automobilindustrie an Qualität und Zuverlässigkeit bei Halbleitern in der Automobilelektronik. Um diesem Trend gerecht zu werden, nutzt ELMOS die Erfahrungen aus den Industrie- und Konsumgütermärkten für neue innovative Technologien als Innovationstreiber. ELMOS profitiert von diesem Sachverhalt z.B. indem in Konsumgütermärkten gereifte Innovationen später im Automobil eingeführt werden und durch eigene – über die Standards hinausgehende – Qualifikationsverfahren abgesichert werden. Dies führt u.a. zu einem höchstmöglichen Qualitätsniveau auch bei neuen Produkten für das Automobil.

Im Berichtsjahr war ein klarer Schwerpunkt der Aktivitäten in Forschung und Entwicklung die Entwicklung des 0,35µm Prozesses und das Starten der Prototyping-Phase dieses Prozesses. Die Fein-Optimierung und die Prozessintegration der am Standort Duisburg in Serie gefertigten Produkte wurden in 2007 ebenfalls intensiv vorangetrieben. Die Fertigung auf 200mm-Wafern bietet ELMOS die Möglichkeit, innovative und kostengünstige Lösungen mit Hilfe eigener Prozesstechnologien anbieten zu können.

Neben den Entwicklungen neuer Prozesse entfällt der mit Abstand größere Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf die Entwicklung neuer Produkte. Inzwischen ist es Marktpraxis, dass ein Großteil der Produktentwicklungskosten vom ASIC-Lieferanten vorfinanziert wird und sich über die Serienfertigung amortisieren muss. Dies trifft natürlich in besonderem Maße für die Entwicklung von ASSP-Familien zu, die zukünftig einen größeren Umsatzanteil von ELMOS als in der Vergangenheit ausmachen werden. In Folge davon stiegen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. Euro auf 30,9 Mio. Euro an, entsprechend einer Quote von 17,5% vom Umsatz.

Mitarbeiter

Als Technologieunternehmen profitiert ELMOS in besonderem Maße vom Know-how der Mitarbeiter. Deren Motivation, Wissen und Flexibilität sind die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für das Wachstum und die Innovationskraft. An den Standorten Dortmund und Duisburg in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland, kann ELMOS auf eine große Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren zugreifen, denn im näheren Umkreis befinden sich mehr als fünfzig Universitäten und Hochschulen. Schon seit der Gründung kooperiert ELMOS eng mit diesen und genießt als einziger Halbleiterhersteller der Region eine Ausnahmestellung.

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Mitarbeitern erfolgt in Dortmund vertrauensvoll und mittels einer Mitarbeitervertretung mit selbst gegebener Satzung. In zahlreichen Ausschüssen werden die Belange der Mitarbeiter untereinander und im Verhältnis zum Vorstand besprochen und geregelt. So gibt es Ausschüsse für soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiterförderung und Wirtschaft.

Mitarbeiterbeteiligung

Im Jahr 2007 wurde erstmalig ein Gratisaktien-Programm (Stock Awards) aufgelegt. Die Stock Awards wurden an besonders verdiente Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Vorstands in Anerkennung für die im Vorjahr erbrachte Leistung vergeben. Die Gewährung dieser Awards soll zum einen die Verbundenheit von ELMOS mit ihren Leistungsträgern zeigen und zum anderen als Motivation für das Engagement und die Leistungsbereitschaft verstanden werden.

Das Stock Award Programm 2007 umfasste 29.000 Aktien, die zuvor an der Börse im Rahmen der Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien zurückerworben wurden. Für die Stock Awards gilt eine Haltefrist von zwei Jahren; davon ausgenommen ist ein Verkauf von Aktien in der erforderlichen Anzahl, so dass die Steuern, die auf den geldwerten Vorteil entstehen, beglichen werden können. ELMOS plant auch für die kommenden Jahren ein ähnliches Stock Award Programm.

Qualität, Sicherheit und Umweltschutz

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS konsequent seine Null-Fehler-Strategie um und erzielt damit ein hervorragendes automobilgerechtes Qualitätsniveau. Regelmäßige Prüfungen der eingesetzten Werkzeuge, die Betreuung der Serienprodukte von der Entwicklung bis zur Fertigung, ständige Analysen und statistische Verfahren ermöglichen das hohe Qualitätsniveau. Interne Labore prüfen nicht nur mögliche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung, sondern auch sensor- und gehäusespezifische Merkmale.

ELMOS betreibt seit Mitte der Neunziger Jahre ein Qualitätsmanagementsystem, das alljährlich gemäß den Anforderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1 auditiert wird. Diese Normen wurden in der ISO/TS 16949: 2002, die weltweite Gültigkeit hat, zusammengefasst. ELMOS Dortmund, ELMOS AP, SMI, ELMOS North America, GED, DMOS und die Fertigung in Duisburg wurden in 2007 gemäß dieser Norm auditiert und zertifiziert.

Das Umweltmanagement gemäß DIN EN ISO 14001 wurde am Standort Dortmund in 2003 durch den TÜV Rheinland zertifiziert und in den nachfolgenden Jahren durch Überwachungsaudits ohne Abweichungen bestätigt. Die Bereiche Arbeits- und Umweltschutz sind direkt dem Vorstand unterstellt. Die ISO 14001 verankert den Umweltschutz systematisch und dauerhaft im Management. ELMOS legt beim Umweltmanagement besonderen Wert auf eine effektive Prävention sowie eine effiziente Ausnutzung von Ressourcen.

Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) ist mit einem mittelbaren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 52,9 Prozent größter Einzelaktionär der ELMOS Semiconductor AG. Daher hat der Vorstand gemäß §§312/313 AktG einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der mit folgender Erklärung gemäß §312 Abs. 3 AktG abschließt:

„Wir erklären, dass unsere Gesellschaft nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen und die Maßnahmen getroffen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Nachteile im Sinne von §312 AktG haben sich aus den Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für uns nicht ergeben.“

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG gemäß HGB

<i>in Millionen Euro oder Prozent, soweit nicht anders angegeben</i>	2006	2007	Veränderung
Umsatzerlöse	143,1	158,4	10,6%
Materialaufwand	58,6	68,0	15,9%
Personalaufwand	33,6	37,0	10,1%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11,0	13,0	18,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	43,2	53,0	22,7%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3,3	-5,0	Na
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2,4	-5,3	na

Umsatz- und Ertragsentwicklung

Das Jahr 2007 war durch ein schwieriges Marktumfeld gekennzeichnet. So spielten die Verunsicherung durch die in den USA ausgelöste Kreditkrise, der schwache US-Dollar und der hohe Ölpreis eine Rolle. Trotz dieser schwierigen Randbedingungen hat ELMOS mit einem Umsatzwachstum von 10,6 Prozent auf 158,4 Millionen Euro erzielt.

Materialaufwand, Abschreibungen und Sonstige betriebliche Aufwendungen sind im Geschäftsjahr 2007 überproportional zum Umsatz gestiegen. Lediglich das Wachstum des Personalaufwands ist in etwa kongruent mit der Umsatzentwicklung. Somit ergab sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von minus 5,0 Mio. Euro. Der Anstieg in den Aufwandspositionen ist im Wesentlichen bedingt durch das Hochfahren der Fertigung am Standort Duisburg.

Finanzlage

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG gemäß HGB

<i>in Millionen Euro oder Prozent, soweit nicht anders angegeben</i>	2006	2007	Veränderung
Periodenergebnis	2,4	-5,3	Na
Abschreibungen / Zuschreibungen	11,2	13,0	16,3%
Veränderungen von Rückstellungen und Gewinn/Verlust aus Anlagenabgängen	0,5	1,3	Na
Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-7,9	1,4	Na
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	11,8	13,1	10,8%
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	18,0	23,6	30,8%
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-15,0	-7,7	-48,4%
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	1,5	9,5	Na
Abnahme / Zunahme der Finanzmittel	4,5	25,3	Na
Finanzmittel am Ende der Periode	11,8	37,1	Na

Trotz deutlich schlechterem Ergebnis als im Vorjahr konnte der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit gesteigert werden. Dies ist insbesondere auf den Rückgang der sonstigen Vermögensgegenstände zurückzuführen. Dies ist begründet durch Vermögensgegenstände, die in Sale-and-Lease-back-Strukturen überführt wurden. Diese begründen auch den in 2007 im Vergleich zur Vorjahresperiode geringeren Cash Bedarf aus der Investitionstätigkeit. Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit stieg vor allem wegen der durchgeführten Umfinanzierung von kurzfristigen in langfristige Verbindlichkeiten, so dass am Bilanzstichtag 2007 auch der Bestand der Finanzmittel deutlich den des Vorjahres überragte.

Vermögenslage

Kennzahlen der ELMOS Semiconductor AG gemäß HGB

<i>in Millionen Euro oder Prozent, soweit nicht anders angegeben</i>	2006	2007	Veränderung
Anlagevermögen	129,6	134,3	3,6%
Vorräte	25,4	29,7	16,7%
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	47,7	32,4	-32,0%
Flüssige Mittel	12,9	38,2	197,0%
Übrige Aktiva	5,9	5,4	-8,5%
Eigenkapital	149,2	143,9	-3,6%
Verbindlichkeiten	64,0	86,0	34,4%
Übrige Passiva	8,2	10,1	22,5%
Bilanzsumme	221,5	240,0	8,4%

Die Bilanzsumme stieg im Vergleich zum 31. Dezember 2006 um 8,4 Prozent auf 240,0 Mio. Euro im Berichtsjahr. Bedingt durch Investitionen hat sich das Anlagevermögen um 3,6 Prozent erhöht. Vorräte sind aufgrund eines Anstiegs der Fertigen Erzeugnisse und Waren angewachsen, sonstige Vermögensgegenstände haben sich in 2007 deutlich rückläufig entwickelt. Abgesehen von diesen Veränderungen erklärt sich die Bilanzverlängerung auf der Aktivseite durch die höhere Position der Flüssigen Mittel. Der Rückgang des Eigenkapitals, verursacht durch den Fehlbetrag wurde überkompensiert von Zuwächsen bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und verbundenen Unternehmen. Die Eigenkapitalquote sank am Bilanzstichtag auf 60,0 Prozent (31.12.2006: 67,4 Prozent).

Berichterstattung nach §289 Abs. 4 HGB i.d.F. des Übernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetzes

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2007 aus 19.414.205 auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von 19.414.205,00 Euro ist voll eingezahlt. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen

Stimmrechts- und Übertragungsbeschränkungen bestehen nicht.

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital

Die Beteiligungsverhältnisse stellen sich bis zum 31. Dezember 2007 wie folgt dar:

	Euro	%
EFH ELMOS Finanzholding GmbH	1.485.789,00	7,7
Makos GmbH	3.236.584,00	16,7
Dr. Weyer GmbH	3.236.584,00	16,7
ZOE-BTG GmbH	2.306.833,00	11,9
Streubesitz	9.148.415,00	47,1
	19.414.205,00	100,0

Inhaber von Aktien mit Sonderrechten

Aktien mit Sonderrechten wurden nicht ausgegeben.

Art der Stimmrechtskontrolle im Falle von Arbeitnehmerbeteiligungen

Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und über Satzungsänderungen

Wir verweisen auf die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften für die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands (§§84, 85 AktG) sowie für die Änderung der Satzung (§§133, 179 AktG). Ergänzende Bestimmungen aus der Satzung ergeben sich nicht.

Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Rückkauf von Aktien

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.650.000,00 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und gem. §204 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Ausgabe zu entscheiden (Genehmigtes Kapital I).

Das Grundkapital ist um 885.795,00 Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogrammes der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu 5.000.000 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionsscheinen oder Wandlungsrechten aus bis zum 09. Mai 2012 durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittelbare inländische oder ausländische 100%-ige Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft gemäß der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 10. Mai 2007 begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren inländischen oder ausländischen 100%-igen Beteiligungsgesellschaften bis zum 09. Mai 2012 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um 930.000 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen („Aktienoptionsplan 2004“). Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27. April 2004 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese wirksam ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 09. November 2008 eigene Aktien zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien, auf die ein Anteil am Grundkapital in Höhe von bis zu insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals entfällt, beschränkt. Die Ermächtigung kann ganz oder in mehreren Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschränkung ausgeübt werden.

Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels in Folge eines Übernahmeangebots stehen

Wesentliche Vereinbarungen für den Fall eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Entschädigungsvereinbarungen

Auch Entschädigungsvereinbarungen bestehen nicht.

Bezüge des Vorstands

Gesamtbezüge des Vorstands

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder orientiert sich an der wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Konzerns. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats berät über eine angemessene Vergütung und die verschiedenen Vergütungsbestandteile. Die Gesamtvergütung umfasst einerseits erfolgsunabhängige Komponenten, wie ein fixes Monatsgehalt, Nebenleistungen, wie Übernachtungskosten und Dienstwagennutzung, Pensionszusagen sowie andererseits erfolgsabhängige Komponenten, wie die Tantieme und die Gewährung von Aktien der ELMOS Semiconductor AG aus einem Incentiveplan (Stock Awards) als Komponente mit langfristiger Anreizwirkung. Die Tantieme leitet sich prozentual aus dem Ergebnis des Konzerns vor Steuern ab.

Auf eine individualisierte Veröffentlichung der Vergütung wird in Anbetracht der Wahrung der Privatsphäre verzichtet. Eine solche Offenlegung trägt nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat nicht zu einer erweiterten Transparenz in Form von zusätzlichen kapitalmarktrelevanten Informationen bei. Aus diesem Grund hat die Hauptversammlung am 19. Mai 2006 beschlossen, die Gesellschaft für einen Zeitraum von fünf Jahren von der durch das Vorstandsvergütungsoffenlegungsgesetz vom 3. August 2005 eingeführten Rechtspflicht zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung zu befreien. Im Geschäftsjahr 2007 beliefen sich die fixen Bezüge der Mitglieder des Vorstands auf 1.655 Tsd. Euro und die variablen Bezüge auf 185 Tsd. Euro. Im Jahr 2007 wurden erstmalig Aktien der ELMOS Semiconductor AG gemäß einem Incentiveplan an die Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Der Gesamtwert der Aktien betrug zum Gewährungszeitpunkt 65 Tsd. Euro. ELMOS hat für Pensionszusagen (unmittelbare Zusagen) gegenüber Mitgliedern des Vorstands Pensionsrückstellungen in Höhe von 611 Tsd. Euro gebildet. Des Weiteren bestehen für Mitglieder des Vorstands der ELMOS Semiconductor AG mittelbare Pensionszusagen, für die aufgrund des Umfangs der Zusage und der vollständig kongruenten Rückdeckung durch eine Rückdeckungsversicherung keine Pensionsrückstellung zu bilden ist. In 2007 beliefen sich die Beiträge für diese Pensionspläne auf 432 Tsd. Euro. Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihre Hinterbliebenen lagen im Geschäftsjahr 2007 bei 79 Tsd. Euro. Ferner wurden für diese Versicherungsprämien in Höhe von 200 Tsd. Euro entrichtet. Die Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2007 betrug 2.536 Tsd. Euro.

Abgesehen von Pensionen sind für den Fall der Beendigung der Tätigkeit keinem Vorstandsmitglied weitere Leistungen zugesagt worden. Ebenso hat kein Mitglied des Vorstands im abgelaufenen Geschäftsjahr Leistungen oder entsprechende Zusagen von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied erhalten.

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in §9 der Satzung festgelegt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer Auslagen eine feste und eine erfolgsorientierte Vergütung. Die erfolgsorientierte Vergütung ist an die Dividende gebunden und damit auf den langfristigen Unternehmenserfolg ausgerichtet. Dem Aufsichtsrat werden keine Aktien der ELMOS Semiconductor AG zugeteilt.

Entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex hinsichtlich der Berücksichtigung des Vorsitzes und stellvertretenden Vorsitzes bei der Vergütung erhält der Vorsitzende das Doppelte und sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der festen Vergütung. Der Vorsitz und die Mitgliedschaft in Aufsichtsratsausschüssen werden nicht gesondert vergütet. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird summiert, jedoch nicht individualisiert ausgewiesen. Dies gilt auch für an Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlte Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere für Beratungs- und Vermittlungsleistungen. Die feste Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug im Geschäftsjahr 2007 in der Summe 92 Tsd. Euro. Spesen und Auslagen sind darin enthalten. Da in 2007 keine Dividende an die Aktionäre ausgezahlt wurde, wurde an die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2007 keine variable Vergütung gezahlt. Für sonstige Dienstleistungen, insbesondere Beratungen und Erfindervergütungen, vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrats 377 Tsd. Euro.

Risiko- und Chancenbericht

Risiko- und Chancenmanagementsystem

ELMOS betreibt ein ganzheitliches Risiko- und Chancenmanagementsystem zur konsequenten Nutzung ihrer Chancen, ohne die damit verbundenen Risiken außer Acht zu lassen. Risiken und Chancen werden regelmäßig analysiert. Die ELMOS Semiconductor AG fasst die innerhalb des Unternehmens vorhandenen Maßnahmen zur Risikosteuerung in einem einheitlichen und durchgängigen Risikomanagementsystem zusammen. Das System entspricht den gesetzlichen Anforderungen an ein Risikofrüherkennungssystem und steht im Einklang mit den Deutschen Corporate Governance Grundsätzen.

Risiken

Abhängigkeit von der Automobilindustrie

Das Kerngeschäft von ELMOS steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage der Automobilindustrie nach ASICs. Rund 90% des Umsatzes wird mit Halbleitern für die Automobilelektronik erwirtschaftet. Diese Nachfrage ist einerseits abhängig von den produzierten Stückzahlen an Fahrzeugen und wird andererseits von dem anhaltenden Trend zu mehr Elektronik im Auto gesteuert. Durch die Zunahme an elektronischer Ausrüstung im Auto steigen die Stückzahlen an verkauften ASICs und ASSPs in der Regel auch dann, wenn die Zahl der produzierten PKWs stagniert oder abnimmt.

Der Automobilmarkt unterlag in der Vergangenheit als Folge von Zusammenschlüssen von Systemherstellern, restriktiver Umweltgesetzgebung und anderen Faktoren, beachtlichen Schwankungen. Die ELMOS-Kundenstruktur deutet auf eine gewisse Abhängigkeit von einigen großen Automobilzulieferern hin. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass ein Kunde in der Regel mehrere Produkte mit verschiedenen Lebenszyklen bezieht. Aufgrund der Tatsache, dass ASICs kundenspezifische Produkte sind, ergibt sich eine besondere gegenseitige Abhängigkeit zwischen Lieferant und Kunde. Abweichend davon kann es bei großen Stückzahlen der Fall sein, dass ein Kunde bei zwei Lieferanten einen ASIC entwickeln lässt. Durch die verstärkte Hinwendung von ELMOS zu anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSP) wird diese Kundenabhängigkeit verringert, da solche Produkte an mehrere Kunden verkauft werden können.

Wettbewerb

Eine Vielzahl von Wettbewerbern im Halbleitermarkt für automobiler Anwendungen bietet ähnliche Produkte wie ELMOS auf vergleichbarer technologischer Grundlage an. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass große Halbleiterhersteller, die bisher noch gar nicht oder nur zu einem geringen Prozentsatz im automobilen Halbleitermarkt tätig sind, in Zukunft versuchen werden, in dieses Marktsegment einzudringen. Da diese Großproduzenten aus Rentabilitätsgründen sich oftmals jedoch auf großvolumige Projekte fokussieren müssen, ist ihr Engagement im Nischenmarkt der kundenspezifischen Schaltungen relativ gering. Damit erscheint das Risiko für ELMOS vergleichsweise gering. Allerdings akquiriert ELMOS in letzter Zeit vermehrt großvolumige Aufträge. Dadurch wird ELMOS in Zukunft mehr in Wettbewerb zu Großproduzenten treten und entsprechenden Preisdruck spüren. Wenn Kunden allerdings Parallelentwicklungen durchführen, so besteht für ELMOS das Risiko, dass diese auf einen Wettbewerber zurückgreifen.

Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern

Die sehr entwicklungsintensive Geschäftstätigkeit des Unternehmens führt zu einem stark ausgeprägten und sehr spezifischen Ingenieur-Know-how – jedoch nur teilweise zu Patenten. Somit ergibt sich für ELMOS, wie für jedes Technologieunternehmen, eine erhöhte Abhängigkeit von bestimmten Mitarbeitern.

Entwicklung neuer Produkte und Technologien

Bei der kundenspezifischen Entwicklung von Produkten ist zu berücksichtigen, dass bei der Akquisition eines neuen Auftrages die Einmalkosten im Entwicklungsbereich heute in der Regel nicht mehr in vollem Umfang von den Kunden bezahlt werden. Diese vorab nicht gedeckten Entwicklungskosten werden über die späteren Stückzahlen in der Serie amortisiert. Hier besteht das Risiko, dass bei Entwicklungen, die nicht in eine Lieferbeziehung münden, nicht amortisierte Kosten bei der Gesellschaft verbleiben. Gerade bei den hochvolumigen Aufträgen, um die sich eine größere Anzahl von Wettbewerbern bemüht, ist der Kunde in der Regel nicht bereit, die Entwicklungskosten zu übernehmen, sondern erwartet, dass diese vom Lieferanten vorfinanziert werden. Dies gilt insbesondere für von ELMOS selbst initiierte Produktentwicklungen, beispielsweise für ASSPs, da hierfür unter Umständen noch kein fester Kundenauftrag vorliegt.

Der Markt für die ELMOS-Produkte ist durch ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte gekennzeichnet. Der ELMOS-Erfolg ist deshalb stark von der Fähigkeit abhängig, neue komplexe Produkte preisgünstig zu entwickeln, sie rechtzeitig im Markt einzuführen und zu erreichen, dass diese Produkte von führenden Zulieferern der Automobilindustrie ausgewählt werden.

Durch die Fähigkeit von ELMOS, Produkte für alle Arten von elektronischen Geräten im Automobil zu entwickeln und zu fertigen, sind ELMOS-Produkte in zahlreichen elektronischen Komponenten eines PKWs vertreten, so dass das Risiko des Wegfalls eines Auftrages für eine einzelne elektronische Komponente breit gestreut ist. Zwar könnte ein mehrjähriger Einbruch der Automobilindustrie, der die Automobilunternehmen veranlasst, keine neuen elektronischen Produkte zu entwickeln, die Gesellschaft in ihrer Entwicklung nachhaltig beeinträchtigen. Ein solcher Einbruch ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abzusehen, insbesondere weil die Automobilindustrie in schlechteren Zeiten eher dazu neigt, die technische Ausstattung zu erhöhen.

Der zukünftige Erfolg von ELMOS ist auch von der Fähigkeit abhängig, neue Entwicklungs- und Produktionstechnologien zu entwickeln. ELMOS entwickelt analoge und digitale Halbleiterstrukturen und -funktionen für ihre selbst entwickelte modulare Hochvolt-CMOS-Prozesstechnologie. Wie die Konkurrenten muss ELMOS ihre Technologie ständig verbessern und neue Prozesstechnologien für die fortschreitende Verkleinerung der Strukturen im Submikronbereich entwickeln. Sollte ELMOS zukünftig nicht in der Lage sein, neue Produkte und Produktverbesserungen zu entwickeln, zu produzieren und abzusetzen, dürfte dies signifikante Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Beschaffung

Die von ELMOS für die Fertigung benötigten Rohstoffe sind weltweit bei verschiedenen Lieferanten verfügbar und unterliegen keinem Monopol. Branchentypisch ist eine gewisse Abhängigkeit von einzelnen fernöstlichen Partnern im Assembly-Bereich. ELMOS hat das Risiko gestreut, indem mit mehreren Partnern zusammengearbeitet wird.

Produkthaftung

Die von ELMOS produzierten Produkte werden als Komponenten in komplexe elektronische Systeme integriert. Fehler oder Funktionsmängel der von ELMOS hergestellten Halbleiter oder der elektronischen Systeme, in die sie integriert sind, können direkt oder indirekt Eigentum, Gesundheit oder Leben Dritter beeinträchtigen. ELMOS ist nicht in der Lage, ihre Haftung gegenüber Abnehmern oder Dritten in ihren Absatzverträgen zu reduzieren oder auszuschließen.

ELMOS verfolgt konsequent eine Null-Fehler-Strategie und investiert stetig in die Erkennung und Vermeidung von Fehlerquellen und Fehlern. So werden die einzelnen Halbleiterchips hinsichtlich ihrer Qualität und Funktion in der Produktion im Regelfall mehrfach bei unterschiedlichen Temperaturen getestet. Obwohl die Gesellschaft weitreichende Testverfahren vor der Auslieferung ihrer Produkte einsetzt, können sich Produktfehler möglicherweise erst beim Verbau oder dem Gebrauch der Produkte durch den Endverbraucher zeigen.

Wenn solche Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwendige Produktmodifikationen nach sich ziehen und zu Beeinträchtigungen in den Kundenbeziehungen sowie zum Verlust von Marktanteilen führen. Ein Qualitätsproblem ganzer Chargen könnte zudem zu Regressansprüchen der Kunden im Millionenbereich führen. Dieses Risiko ist angemessen versichert. Dennoch können diese Risiken negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

Beteiligungsbereich

Durch die hohe Allokation von finanziellen Mitteln in die Tochtergesellschaften besteht die erhöhte Pflicht, mit entsprechenden Controlling-Instrumenten und kontinuierlichen Soll-Ist-Analysen mögliche finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen bzw. zu minimieren. Hierfür wird das installierte Überwachungs- und Risikomanagementsystem laufend erweitert und verbessert.

Betriebsunterbrechung

Neben den bereits dargestellten und erläuterten Geschäftsrisiken ist nach Einschätzung von ELMOS das einzige wesentliche betriebliche Risiko, das die Entwicklung des Konzerns beeinträchtigen und den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnte, das Risiko der Zerstörung der Fertigungsanlagen durch Feuer oder andere Katastrophen. Zwar ist das Betriebsunterbrechungsrisiko durch solche Ereignisse angemessen versichert, jedoch bestünde in einem solchen Fall eine erhebliche Gefahr des Verlustes von Schlüsselkunden. Dieses Risiko ist nicht versicherbar.

Dieses Risiko ist dadurch bereits reduziert, dass seit 2006 eine weitere Fertigungslinie (200mm-Linie) am Standort Duisburg betrieben wird. Zu einem späteren Zeitpunkt kann auch am Standort Dortmund in einem separaten Gebäude eine weitere Produktionslinie errichtet werden. Damit verfügt ELMOS über mehrere unabhängige Fertigungslinien, die autark produzieren können.

Die üblichen versicherbaren Risiken wie Feuer, Feuerbetriebsunterbrechung, Wasser, Sturm, Diebstahl, Haftpflicht, insbesondere Produkthaftpflicht, auch in den USA, sowie die Kosten eines etwaigen Rückrufs, sind angemessen versichert. Weitere Risiken, die die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeinträchtigen oder den Fortbestand des Konzerns gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

Chancen

Kernkompetenz und Motor unseres aktuellen Wachstums sind kundenspezifische Halbleiter. Zudem arbeiten wir mit hohem Engagement am Eintritt in neue Märkte, sowohl aus technischer als auch aus geographischer Sicht. Aus technischer Sicht ist vor allem die Zusammenführung von Sensoren und Auswerteelektronik in einem applikationsspezifischen Gehäuse – sogenannte Mikrosysteme – interessant. Des Weiteren ist geplant, dass zukünftig Produkte für Konsumgüter und Industrieanwendungen einen höheren Anteil als bisher am Umsatz erzielen. In 2007 haben unsere Bemühungen in Asien signifikante Fortschritte gemacht. Wir stehen in regem Kontakt mit Geschäftspartnern und werden unser Engagement in Asien weiter verstärken. Im Hinblick auf applikationsspezifische Bauteile (ASSPs) werden in Zukunft die Entwicklungs- und Vertriebstätigkeiten mit starkem Fokus weitergeführt.

Nachtragsbericht

Bis zum 25. Februar 2008 hat ELMOS 50.000 eigene Aktien (entsprechend 0,26% des Grundkapitals) zurückgekauft.

Anfang 2008 haben ELMOS und MagnaChip Semiconductor Ltd. einen Kooperationsvertrag für die Entwicklung von automobilen Halbleitertechnologien unterzeichnet. In einem zweiten Schritt wird ELMOS die Fertigungsdienstleistungen (Foundry Services) von MagnaChip in Anspruch nehmen. Diese Kooperation ermöglicht ELMOS ein schnelles Reagieren auf schwankende Produktvolumina durch einen flexiblen und verlässlichen Dienstleister. Die prozessierten Wafer von MagnaChip werden unter dem Management von ELMOS getestet und assembliert. Die Partnerschaft soll unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit im Markt steigern und stellt einen weiteren Meilenstein in unserem Netzwerk von Kooperationen dar.

Darüber hinaus sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten.

Prognosebericht

Mittelfristig erwarten Marktforschungsinstitute Wachstumsraten von rund 7% bis 8% pro Jahr für den automobilen Halbleitermarkt. Dabei spielt nach wie vor der anhaltende Wachstumstrend der Elektronik im Automobil eine größere Rolle als eine Veränderung der Produktionszahlen in der Automobilindustrie. So soll der Elektronikanteil im Automobil stetig steigen.

Im Jahr 2008 spielen die Unsicherheiten über den weiteren Fortgang der Ereignisse am Immobilienmarkt in den USA und an den internationalen Finanzmärkten eine Rolle und überschatten den wirtschaftlichen Ausblick. Darüber hinaus hat die Entwicklung des Ölpreises einen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung. Wir erwarten, dass das Marktumfeld nach wie vor schwierig bleiben wird.

ELMOS will in 2008 ihre Position als führendes Unternehmen der automobilen Halbleiterbranche ausbauen, gleichzeitig aber auch stärker in neue Märkte vordringen. ELMOS profitiert von der in 2007 gelegten Basis und wird sich in 2008 insbesondere auf die folgenden Themen konzentrieren:

- Optimierung des Standorts Duisburg
- Start der teilweisen Umstellung der Fertigung in Dortmund von 6-Zoll auf 8-Zoll
- Verbesserte Nutzung der Marktchancen für Mikrosysteme
- Vermehrter Vertrieb von ASSPs
- Verstärkte Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern zur Optimierung des Produktportfolios und Reduktion der Investitionen
- Steigerung der Aktivitäten in Neuen Märkten (Industrie- und Konsummärkte, Asien)

Gegen den Markttrend konnte ELMOS in 2007 ihre Prognose für das Berichtsjahr bekräftigen und erfüllen und auch für 2008 einen soliden Ausblick kommunizieren. Dies ist unter anderem das Resultat der in den vergangenen Jahren geleisteten Verbesserungen im Rahmen der Qualitätsinitiative und daraus folgendem Vertrauen, welches die Kunden in ELMOS setzen.

Dortmund, im März 2008

Der Vorstand

Dr. Anton Mindl

Nicolaus Graf von Luckner

Reinhard Senf

Dr. Frank Rottmann